

半導体パッケージの基礎と品質管理 および最新動向

講師：池永 和夫 氏

サクセスインターナショナル株式会社 半導体セミナーの講師、コンサルタント

パッケージに求められる機能およびパッケージの種類の変遷について解説し、またパッケージの製作プロセスの説明とその課題について解説する。さらに最近のパッケージ動向としてSiP, WLP, FOWLP, TSV技術などを例に解説する。

【講師経歴】ソニー株式会社入社後、半導体パッケージの開発、生産に従事。ハイブリッド事業部 事業部長、半導体関連会社役員を担当。 ソニー株式会社退社後、サクセスインターナショナル株式会社に入社し、半導体セミナーの講師、コンサルタントに従事する。

【活動】半導体産業人協会主催・半導体入門講座・半導体ステップアップ講座の「半導体パッケージング技術」の講師を担当。

開催日時	2025年8月29日（金）10:30～16:00	※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。詳細は裏面をご覧ください。 ★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。
受講料	55,000円（税込） ※資料付 * メルマガ登録者 49,500円（税込） * アカデミック価格 26,400円（税込）	

*アカデミック価格：学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。

★【メルマガ会員特典】2名以上同時申込かつ申込者全員がメルマガ会員登録していただいた場合、1名あたりの参加費がメルマガ会員価格の半額となります。

★【セミナー対象者】パッケージ技術に関する若手技術者、装置メーカー、材料メーカーの技術および営業担当者、マーケティング担当者など。また、広く半導体関連の技術、知識を習得したい人

★【セミナーで得られる知識】パッケージに求められる機能を理解し、パッケージ技術の変遷とその要素技術に関する知識とパッケージに関する品質管理の知識が得られる。それにより、パッケージの形状、工程の意味と関連性が深く理解できるようになる。また、最新のパッケージ技術の課題を把握する事により将来のパッケージ開発、材料・装置開発などに役立てることが出来る。また、異業種間でのコミュニケーションを図ることが出来るようになる。

【本ウェビナーのプログラム】

※適宜休憩が入ります。

1. 半導体パッケージとは	2-8. マーキング工程
1-1. パッケージに求められる機能	2-9. 測定工程
1-2. パッケージの変遷と種類	2-10. 梱包工程
1-3. パッケージの構造と接続法	3. パッケージの品質
2. パッケージの各組み立て工程（後工程）の特徴・ポイントと課題およびその対策	4. パッケージの技術動向と各技術の特徴・課題
2-1. バックグラインディング工程	4-1. パッケージの電気特性と多ピンパッケージ
2-2. ダイシング工程	4-2. WLP (Wafer level Package)
2-3. ダイボンディング工程	4-3. FOWLP (Fan-Out Wafer level Package)
2-4. ワイヤボンディング工程	4-4. SiP (System in Package)
2-5. モールド封止工程	4-5. TSV (Through Silicon Via)
2-6. バリ取り・端子めっき工程	4-6. チップレット化と三次元パッケージ
2-7. トリム＆フォーミング工程	5. まとめ

弊社記入欄	ウェビナー申込書		
セミナー名	半導体パッケージの基礎と品質管理および最新動向		
所定の事項に ご記入下さい <u>メルマガ会員、 登録希望の場合は○↓</u>	会社名（団体名） 住 所 〒	TEL : FAX : E-mail :	
会員登録 済み	新規 登録希望	部署	役職
お支払方法	銀行振込・その他		氏 名
	お支払予定	2025年 月 日頃	

■申込方法：セミナー申込書にご記入の上FAXまたはE-mail(order_7053@cmcre.com)でお申し込みください。

■セミナーお申込み後のキャンセルは基本的に受けしておりません。ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

■申込先：株シーエムシー・リサーチ 東京都千代田区神田錦町2-7 TEL03-3293-7053

■本セミナーの関連情報は、弊社HPでもご覧になれます。⇒ <https://cmcre.com>

参加申込FAX番号
03-3291-5789

2025年8月29日（金）開催

半導体パッケージの基礎と品質管理 および最新動向

講 師： 池永 和夫 氏

サクセスインターナショナル株式会社 半導体セミナーの講師、コンサルタント

当該セミナーは、**ライブ配信のウェビナー（オンラインセミナー）**です！

【ライブ配信対応セミナー】

- ・本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
お申し込み前に、下記 URL より視聴環境をご確認ください。
→ <https://zoom.us/test>
- ・当日はリアルタイムで講師へのご質問も可能です。
- ・タブレットやスマートフォンでも視聴できます。
- ・お手元の PC 等にカメラ、マイク等がなくてもご視聴いただけます。この場合、音声での質問はできませんが、チャット機能、Q&A 機能はご利用いただけます。
- ・ただし、セミナー中の質問形式や講師との個別のやり取りは講師の判断によります。ご了承ください。
- ・「Zoom」についてはこちら↓をご参照ください。

<https://zoom.us/jp-jp/meetings.html>

【お申込み後の流れ】

- ・開催前日までに、ウェビナー事前登録用のメールをお送りいたします。お手数ですがお名前とメールアドレスのご登録をお願いいたします。
- ・事前登録完了後、ウェビナー参加用 URL をお送りいたします。
- ・セミナー開催日時に、参加用 URL よりログインいただき、ご視聴ください。
- ・講師に了解を得た場合には資料を PDF で配布いたしますが、参加者のみのご利用に限定いたします。他の方への転送、WEB への掲載などは固く禁じます。
- ・資料を冊子で配布する場合は、事前にご登録のご住所に発送いたします。開催日時に間に合わない場合には、後日お送りするなどの方法で対応いたします。

【注意事項】

- ・本セミナーの受講にあたっての推奨環境は「Zoom」に依存します。受講者の方のお手元の PC などの設定や通信環境が受信の状況に大きく影響いたしますので、ご自分の環境が対応しているか、お申し込み前の確認をお勧めいたします。
<https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-MacLinux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6>
- ・Zoom クライアントは最新版にアップデートして使用してください。
- ・インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合がありますが、予めご了承ください。
- ・万が一、当社や講師側（開催側）のインターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止した場合には、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
- ・本セミナーはお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
- ・受講中の録音・撮影等は固く禁じます。
- ・Zoom のグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。